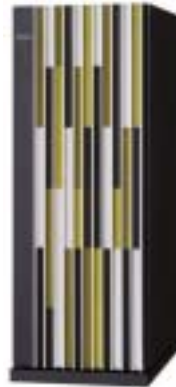


2007年5月23日

エンタープライズサーバ「EP8000 シリーズ」に  
新世代プロセッサ POWER6 を搭載したミッドレンジモデルを追加し、  
従来比でトランザクション処理性能を最大約 1.6 倍に大幅強化



EP8000 570  
(POWER6 搭載)

日立製作所 情報・通信グループ(グループ長&CEO:篠本 学、以下、日立)は、このたび、高性能・高信頼のミッションクリティカルなエンタープライズサーバ「EP8000 シリーズ」において、新世代プロセッサ POWER6 を搭載し、処理性能を大幅に強化したミッドレンジモデルの「EP8000 570」POWER6 搭載モデルをラインアップに追加し、5月25日から販売を開始します。

今回新たに採用した POWER6 プロセッサは、現行の POWER5+プロセッサの2倍以上(最大 4.7GHz)に動作周波数を高めたのをはじめ、命令の並列処理効率の向上、キャッシュメモリ系アーキテクチャーの大幅改善などを図っています。これにより、現行モデルに比べ最大約 1.6 倍のトランザクション処理性能向上を実現しています。

「EP8000 シリーズ」は、日立が長年メインフレームで培った高信頼設計技術や、冗長構成に対応した電源および冷却ファン、ホットスワップ(\*1)可能な内蔵ディスクや PCI(\*2)スロットなどにより、オープンプラットフォーム環境でのミッションクリティカルシステムとして十分に対応できる高信頼性、高可用性を備えた UNIX サーバです。これまでに、金融機関をはじめ、電力、交通といった社会基盤や企業の基幹業務において採用実績があります。

\*1)ホットスワップ: コンピュータの電源を入れたまま、パーツやケーブルを交換すること。

\*2)PCI(Peripheral Component Interconnect): パソコン内部の各パーツ間を結ぶバス(データ伝送路)の規格。

## 新モデルの特徴

### 1. トランザクション処理性能を最大約 1.6 倍向上

POWER6(4.7/4.2/3.5GHz)を最大 16way 構成まで可能なモデルで、POWER5+を搭載した従来の「EP8000 570」に比べトランザクション処理性能を最大約 1.6 倍向上し、上位モデルに迫る高い処理性能を実現しています。また、メモリ容量は最大 768GB まで、拡張 PCI スロット数は最大 212 スロットまで増強でき、拡張性にも優れているため、中/大規模のデータベースやオンライントランザクション処理システムに適しています。

### 2. ハードウェア資源仮想化機能によるハードウェアリソース有効活用

新モデルは、現行 POWER5+搭載モデル同様、高度なハードウェア資源仮想化機能をサポートしています。1 台の「EP8000 570」を論理的に分割し、最大 160 台のサーバとして利用する事が可能です。これにより、ハードウェアリソースのより有効な活用による TCO 削減や、ビジネス規模の変化に合わせた迅速かつ柔軟なシステム構成変更・増強を行うことができます。

### 3.メインフレームクラスの信頼性と可用性

「EP8000 シリーズ」は、高速系切替え機能などの日立独自の高信頼化機能を備えています。また、国内外で実績のある日立ディスクアレイサブシステムならびに統合システム運用管理ソフトウェア「JP1」などの日立ミドルウェアとの組合せにより、基幹システムとして十分に対応できる高信頼性、高可用性を実現します。

また、現行 POWER5+搭載モデル同様、システム導入支援や性能設計支援など各種テクニカルサービスを提供するとともに、ハードウェア、OSの一体化したサポートを、ユーザーのニーズに合わせた3つのレベル(シルバー、ゴールド、プラチナ)で提供します。これによりハードウェア、ソフトウェア、サポートサービスを含めたトータルなシステムとしてユーザーのミッションクリティカルな業務を支えます。

#### 新製品の概要

モデル	形状	プロセッサ (周波数)	最大プロセッサ数 (way)	メモリ容量	拡張 PCI スロット数
EP8000 570	ラックマウント	POWER6(4.7/4.2/3.5GHz)	16	4GB ~ 768GB	最大 212

#### 新製品の価格と出荷時期

モデル	価格	出荷時期
EP8000 570	19,426,785 円 ~ (税抜 18,501,700 円 ~)	2007 年 6 月 29 日

今回の発表にあたり、以下のコメントをいただいています。

#### IBM コーポレーション システムズ・アンド・テクノロジー・グループ アライアンス・アンド・ビジネス・デベロップメント担当バイス・プレジデント マリー・コーチャー氏

私たちは、IBMと日立との戦略的アライアンスのもとで、新世代プロセッサPOWER6を搭載した「EP8000 570」を市場に提供できることをうれしく思います。POWER6は、ミッションクリティカルシステムに必要な高性能かつ高信頼性を備えた次世代プロセッサであり、それを採用した「EP8000シリーズ」がお客様のシステムに採用され高い価値をもたらすことを期待します。

#### 他社商標注記

- ・AIX、IBM は、米国における米国 International Business Machines Corp.の登録商標です。
- ・POWER5+、POWER6 は、米国における米国 International Business Machines Corp.の商標です。
- ・UNIX は、X/Open Company Limited が独占的にライセンスしている米国ならびに他の国における登録商標です。
- ・その他、記載の会社名、製品名はそれぞれの会社の商標もしくは登録商標です。

#### 製品情報

<http://www.hitachi.co.jp/EP8000/>

#### 取扱事業部・照会先

株式会社 日立製作所 情報・通信グループ  
エンタープライズサーバ事業部 企画部【担当:石口】  
〒259 - 1392 神奈川県秦野市堀山下1番地  
電話:0463 - 87 - 6786(ダイヤルイン)

以上

## 新製品の特徴

## 1. 「EP8000 570」POWER6 搭載モデルの特徴

POWER6(4.7/4.2/3.5GHz)を最大 16way まで搭載可能なミッドレンジモデルです。これまでの POWER5+を搭載した「EP8000 570」に比べトランザクション処理性能を最大約 1.6 倍向上し、上位モデルに迫る高い処理性能を発揮します。また価格性能比においても同等クラスの他社モデルと比べ、優れています。

スケーラブルなシステム構築を実現するスタックブル SMP 構成を採用しており、基本ブロックとなる 4way 構成の CPU ドロワー(4U(\*1))を最大 4 つまで接続することにより 16way 構成まで拡張可能で、業務の規模や処理量に応じて、最適なコストでシステムの導入および拡張が行えます。メモリは最大 768GB、PCI-X スロットは I/O ドロワーを接続することで最大 212 スロットまで増強できるなど、処理性能だけでなくシステム拡張性も優れています。優れた性能と拡張性を兼ね備えた「EP8000 570」POWER6 搭載モデルは、中規模から大規模の業務システム、データベース、オンライントランザクション処理システムなどに対応可能なモデルです。

(\*1) ラック搭載時の占有サイズ(1U=高さ約 44.5mm)。

## 2. ハードウェア資源仮想化機能によるハードウェアリソース有効活用

新モデルは、現行 POWER5+搭載モデル同様、マイクロパーティショニング機能に対応した動的論理分割(Dynamic LPAR (\*2))に対応しています。マイクロパーティショニング機能により、1 つのプロセッサを論理的に分割し最大 10 パーティションで共有することが可能です。「EP8000 570」では最大 160 パーティション(16way 構成時)に分割できます。

物理的なプロセッサ数にとらわれることなく各パーティションにプロセッサ能力を割り当てられるため、システムの使用効率高めることが可能です。このほか、上位機種と同様に LAN およびストレージの仮想化機能もサポートしています。

これらハードウェア資源仮想化機能により、ハードウェアリソースのより有効な活用による TCO 削減や、ビジネス規模の変化に合わせた迅速かつ柔軟なシステム構成変更・増強を行うことができます。

(\*2) LPAR: Logical Partition

## 3. メインフレームクラスの信頼性と可用性

今回の新モデルも従来の「EP8000 シリーズ」と同様、動的プロセッサ切り離し機能、PCI バス障害回復機能、動的 PCI アダプタ切り離し機能など、様々な高信頼化機能をサポートしています。これにより、システム停止につながる障害発生を大幅に低減します。

また、高可用性ソフトウェア「HA モニタ」とスケーラブルデータベース「HiRDB」によるクラスタ構成において、現用系システムの OS 障害発生と同期した待機系システムへの即時切替え通知や、現用系システムから待機系システムへの共有ディスクの高速切替えを実現するソフトウェア「HA Booster Pack for AIX」を用いることにより、これまで数分程度の時間を必要とした障害時のシステム系切替えを十数秒という極めて短い時間に実行することができるなど、ハードウェアとしてだけでなく、システム運用面での高い信頼性・可用性も備えています。

## 4. 最新のソフトウェア環境を提供

オペレーティングシステム(OS)は、POWER6/POWER5+搭載モデルの性能・機能を最大限に引き出す米国 IBM 社の最新版 UNIX OS「AIX V5.3」に対応しています。

「AIX V5.3」は、優れたパフォーマンス、信頼性・可用性、Linux との高い親和性に加え、セキュリティや Java 実行環境などネットビジネス構築のためのオープンかつミッションクリティカルな基盤機能も提供します。ミドルウェア/アプリケーションには、基幹業務システムで実績のある日立オープンミドルウェア

製品に加え、DBMS (\*4) 製品 Oracle<sup>R</sup>や SAP<sup>R</sup> R/3<sup>R</sup>を含む SAP の E ビジネスプラットフォーム mySAP.com<sup>R</sup>など豊富な ISV (\*5) 製品が利用でき、幅広いニーズに対応したシステムを構築することが可能です。

(\*4) DBMS: Database Management System

(\*5) ISV: Independent Software Vendor

#### 他社所有商標に関する表示

- ・AIX、IBM は、米国における米国 International Business Machines Corp.の登録商標です。
- ・Java 及びすべての Java 関連の商標及びロゴは、米国およびその他の国における米国 Sun Microsystems, Inc.の商標または登録商標です。
- ・Linux は、Linus Torvalds の米国およびその他の国における登録商標あるいは商標です。
- ・Oracle は、Oracle Corporation の登録商標です。
- ・POWER6、POWER5+は、米国における米国 International Business Machines Corp.の商標です。
- ・SAP<sup>R</sup>、R/3<sup>R</sup>、mySAP.com<sup>R</sup>は、SAP AG のドイツおよびその他の国における登録商標または商標です。
- ・UNIX は、X/Open Company Limited が独占的にライセンスしている米国ならびに他の国における登録商標です。
- ・その他、記載の会社名、製品名はそれぞれの会社の商標もしくは登録商標です。

#### 新製品の仕様

モデル		EP8000 570 POWER6搭載モデル		
形状		ラックマウント		
プロセッサ	プロセッサ名称	POWER6		
	クロック・レート (GHz)	3.5	4.2	4.7
	プロセッサ数 (way)	4 ~ 16 <sup>*3</sup>		
レベル2キャッシュ(MB <sup>*1</sup> )		4 (1wayあたり)		
レベル3キャッシュ(MB <sup>*1</sup> )		32 (2wayあたり)		
メモリ容量	最小 ~ 最大(GB <sup>*1</sup> )	4 ~ 384 <sup>*3</sup>	4 ~ 768 <sup>*3</sup>	
ディスク容量	最小 ~ 最大(GB <sup>*2</sup> )	73.4 ~ 79, 200 <sup>*3 *4</sup>		
拡張PCI-X スロット本数	CPUドロー	PCI-Express<x8>: 4		
	I/Oドロー(ディスクベイ無)	PCI-X: 2		
	I/Oドロー(ディスクベイ有)	PCI-X: 6		
CPUドロー - 数		1 ~ 4		
I/Oドロー(ディスクベイ無)		0 ~ 32		
I/Oドロー(ディスクベイ有)		0 ~ 20		
外形寸法 (W×D×H:mm)	CPUドロー	483×824×174 (4U <sup>*5</sup> )		
	I/Oドロー(ディスクベイ無)	224×800×172 (4U <sup>*5 *6</sup> )		
	I/Oドロー(ディスクベイ有)	482×610×178 (4U <sup>*5</sup> )		
搭載筐体		標準ラック筐体 (23U ~ 42U) <sup>*7</sup>		
電源電圧(V)		200 ~ 240 (単相)		
省エネ法に 基づく表示	区分	c		
	エネルギー消費効率	0.008		
搭載OS		AIX version 5.3 または AIX version 5.2		

エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。

(\*1) 1MB(メガバイト)=1,024<sup>2</sup>バイト, 1GB(ギガバイト)=1,024<sup>3</sup>バイトです。

(\*2) 1GB(ギガバイト)=1,000<sup>3</sup>バイトです。

(\*3) CPUドロー 4台接続時

(\*4) I/Oドロー(ディスクベイ有) 20台接続時。

(\*5) ラック搭載時の占有サイズ(1U=高さ約44.5mm)。

(\*6) 4Uのラックスペースに2台並べて搭載します。

(\*7) ラック筐体は、下記のうちから選択できます。

23Uラック筐体(格納サイズ23U)外形寸法 647×1,104×1,193 (W×D×H:mm)

36Uラック筐体(格納サイズ36U)外形寸法 644×1,042×1,804 (W×D×H:mm)

42Uラック筐体(格納サイズ42U)外形寸法 647×1,104×2,015 (W×D×H:mm)

以上

---

このニュースリリース記載の情報(製品価格、製品仕様、サービスの内容、発売日、お問い合わせ先、URL 等)は、発表日現在の情報です。予告なしに変更され、検索日と情報が異なる可能性もありますので、あらかじめご了承ください。

---